

ROLLO DE SOLDADURA 0.8mm 200g (Sn99/Ag0.3/Cu0.7) (2.0% Flux) SAC307

SOLDA-0.8MM/SAC307



Descripción:

El rollo de soldadura SAC307 Sn99/Ag0.3/Cu0.7 con núcleo de flux al 2% es una solución libre de plomo diseñada para aplicaciones electrónicas profesionales que requieren alta confiabilidad y cumplimiento ambiental. Su dosificación habitual es del 2 %.

El diámetro del alambre puede superar los 0,15 mm. Este tipo de aleación es actualmente uno de los estándares más utilizados en la industria electrónica debido a su excelente balance entre resistencia mecánica, humectabilidad y desempeño térmico, siendo ideal tanto para procesos de soldadura manual como retrabajo en tarjetas electrónicas.

Características:

- Aleación Sn99 / Ag0.3 / Cu0.7 (SAC307)
- Composición estándar libre de plomo con excelente desempeño en aplicaciones electrónicas.
- Cumple con normativas ambientales como RoHS.
- Excelente humectabilidad y fluidez
- Permite uniones firmes, confiables y homogéneas.
- Adecuado para aplicaciones industriales, mantenimiento y ensamble.
- Compatibilidad con soldadura manual y retrabajo
- Ideal para técnicos, ingenieros y producción.

Especificaciones:

Parámetro	Valor
Tipo de producto	Alambre de soldadura con núcleo de flux
Aleación	Sn99 / Ag0.3 / Cu0.7 (SAC307)
Diámetro	0.80 mm
Peso	200 g
Contenido de flux	0.02
Tipo de flux	Rosin / No-clean
Punto de fusión	217 – 220 °C
Normativa	RoHS (libre de plomo)
Forma	Rollo

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Alan Gael Garcia Huerta

Revisó

Ing. Kevin Cristian González Santos

Fecha

20/05/2026

